

Wichtige Ereignisse im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2006

Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

- Infineon hat als erster Halbleiterhersteller im Automobilbereich weltweit die Volumenproduktion von 32-Bit-Embedded-Flash-Mikrocontrollern in 130-Nanometer-Technologie aufgenommen. Bosch und SiemensVDO gehören zu den ersten Kunden, die diese Mikrocontroller der AUDO-NG-Produktfamilie von Infineon verwenden. Entwickelt wurden die neuen Mikrocontroller für den Einsatz in Motor- und Getriebesteuerungen für Pkw, Lkw und Motorräder.
- Im zweiten Quartal verzeichnete Infineon eine anhaltend starke Nachfrage nach seinen Hochvolt-MOSFET-Produkten CoolMOS und CoolFET, die unter anderem in Consumer-Geräten wie DVD-Rekordern, LCD-Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen zum Einsatz kommen. Das Wachstum wird getragen von der hohen Nachfrage nach Consumer-Produkten auf Grund von Großereignissen wie der Fußballweltmeisterschaft im Juni 2006.
- Sicherheits-Mikrocontroller aus dem Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs von Infineon haben erfolgreich die weltweit strengsten Sicherheitstests für Chipkarten-Applikationen absolviert und das Zertifikat „Evaluation Assurance Level 5 Plus“ erhalten. Dieses Zertifikat gilt für alle acht kontaktbasierte 16-Bit-Sicherheits-Mikrocontroller der 66PE-Produktfamilie, die für sichere Zahlungsabwicklung und Identifizierung eingesetzt werden, sowie für zwei hochsichere 32-Bit-Sicherheits-Mikrocontroller der 88-Produktfamilie.
- Für die beste Performance bei Logistik und Qualität im Geschäftsjahr 2005 wurde Infineon von Siemens Medical Components aus insgesamt 1000 Lieferanten unter die ersten drei gewählt.
- Im Januar 2006 hat Infineon sein neues Entwicklungszentrum in Bukarest, Rumänien, eröffnet. Dort sollen bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2006 bis zu 120 Entwickler beschäftigt sein, die hauptsächlich an Leistungshalbleitern für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Chipkarten-Sicherheitscontrollern arbeiten.
- Infineons neue Produktionsstätte in Kulim, Malaysia, hat den Bauabschnitt „Ready For Equipment“ planmäßig im März erreicht. Jetzt kann das Reinraum-Equipment eingebracht werden. Die Front-End-Anlage soll hauptsächlich Leistungshalbleiter für die Automobil- und Industrieelektronik produzieren und die Volumenproduktion voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 aufnehmen.

Communication Solutions

- Im zweiten Quartal hat T-Com, der Festnetzbereich der Deutschen Telekom AG, bekannt gegeben, dass bei der Einführung des neuen VDSL2-Netzwerks ausschließlich Breitbandzugangssysteme mit dem VINAX™-Chipsatz von Infineon eingesetzt werden. Im zweiten Quartal hat Infineon Chipsätze für über 500.000 VDSL2-Anschlüsse ausgeliefert.
- Samsung wird seine neuen EDGE-Mobiltelefone mit dem CMOS-Single-Chip Radio Frequency(RF)-Transceiver SMARTi PM von Infineon ausrüsten. Darüber hinaus erreichte Infineon Design-Wins mit seinen RF-Transceivern bei zwei anderen wichtigen Kunden.
- Infineon begann mit der Auslieferung großer Stückzahlen seiner 1-Chip-GSM/GPRS-RF-Basisbandlösung E-GOLDradio und erreichte einen neuen Design-Win für seine EDGE-Multimedia-Plattform MP-E bei einem wichtigen Kunden.
- Auf der Fachmesse 3GSM in Barcelona im Februar 2006 hat Infineon verschiedene neue Produkte angekündigt:
 - Panasonic Mobile Communications hat sich für den Einsatz der Infineon-Plattform MP-EU in seinen neuen 3G-Mobiltelefonen entschieden.
 - Infineon hat mit E-GOLDvoice™ eine 1-Chip-Lösung für Mobiltelefone vorgestellt, die einen Basisband-Prozessor, einen RF-Transceiver, eine Power-Management-Einheit und SRAM enthält. Die Lösung ermöglicht die Produktion von extrem kostengünstigen Mobiltelefonen mit einem Materialpreis von insgesamt etwa 16 US-Dollar.
 - Infineon kündigte die Verfügbarkeit von Mustern seines neuesten Basisband-Prozessors S-GOLD3H an. Der Prozessor unterstützt HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)–Datenraten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde. Das Unternehmen liefert sämtliche Hauptkomponenten für Mobiltelefone, die HSDPA mit 7,2 Megabit pro Sekunde unterstützen: den Basisband-Prozessor, RF-Transceiver, Power-Management-IC, Protokoll-Stack, Application-Framework-Software und Connectivity-Lösungen.

Speicherprodukte

- Das Unternehmen erreichte Design-Ins bei wichtigen Kunden für sein Fully Buffered Dual In-Line Memory Module (FB-DIMM).
- Die Entwicklung der 75-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie verlief im zweiten Quartal weiter nach Plan.
- Der Hochlauf der Volumenproduktion von Speicherchips im 300-Millimeter-Werk von Infineon in Richmond/Virginia verlief im zweiten Quartal weiter planmäßig. Mehr als 20.000 Wafer-Starts pro Monat wurden bereits während des zweiten Quartals erreicht.
- Inotera Memories Inc., das Joint Venture von Infineon mit Nanya Technology Corp., hat am 17. März 2006 erfolgreich den Börsengang an der Taiwanesischen Börse abgeschlossen.